

Title (en)

Connecting element, method for attaching a connection element to a circuit board and circuit board

Title (de)

Anschlusselement, Verfahren zum Aufbringen eines Anschlusselements auf eine Leiterplatte und Leiterplatte

Title (fr)

Élément de raccordement, procédé d'application d'un élément de raccordement sur une carte de circuits imprimés et carte de circuits imprimés

Publication

EP 2945232 A1 20151118 (DE)

Application

EP 14465509 A 20140516

Priority

EP 14465509 A 20140516

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Anschlusselement zum Aufbringen auf eine Leiterplatte, welches eine Anzahl von Anschlussstiften aufweist und mittels zumindest eines Stabilisierungsstabs stabilisiert wird. Dies verhindert eine Verformung bei Verarbeitungsschritten, welche bei hoher Temperatur durchgeführt werden. Die Erfindung betrifft des Weiteren ein Verfahren zur Herstellung einer Leiterplatte sowie eine Leiterplatte mit einem Anschlusselement.

IPC 8 full level

H01R 43/24 (2006.01); **H01R 12/51** (2011.01); **H01R 13/46** (2006.01)

CPC (source: EP)

H01R 12/51 (2013.01); **H01R 13/46** (2013.01); **H01R 43/24** (2013.01)

Citation (search report)

- [X] US 2005032434 A1 20050210 - ZHANG CHI [CN], et al
- [X] DE 102012200918 A1 20130725 - BOSCH GMBH ROBERT [DE]
- [X] EP 1873866 A2 20080102 - DELPHI TECH INC [US]
- [A] US 2002115340 A1 20020822 - YAMANE HIROSHI [JP]
- [A] EP 0511774 A1 19921104 - YAMAICHI ELECTRIC CO LTD [JP]

Cited by

EP3641067A1

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA ME

DOCDB simple family (publication)

EP 2945232 A1 20151118; EP 2945232 B1 20180711

DOCDB simple family (application)

EP 14465509 A 20140516